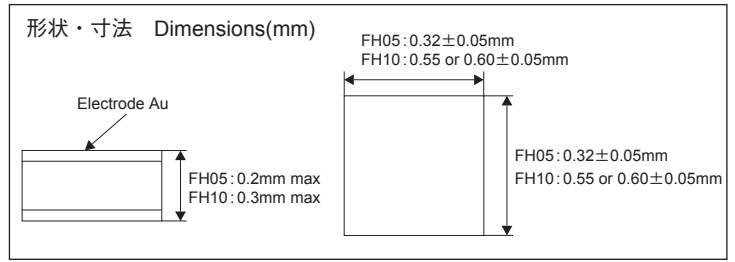
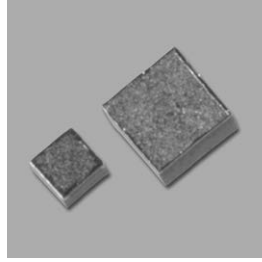
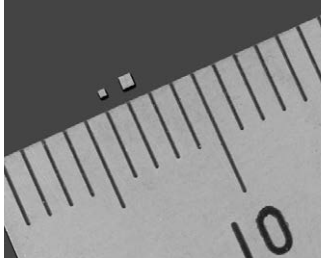


## 光通信モジュール用

## For Optical communication related equipment

### FH05/10

### FH05/10



### ■特長

- 小型で高精度である
- 長期信頼性に優れている
- はんだ濡れ性、ボンディング性に優れている
- Au/Snはんだ実装時の安定性に優れている (約300℃)

### ■Features

- Small precision type
- Long-life Reliability
- Excellent solderability, bondability
- Excellent stability against Au/Sn soldering process (about 300℃)

### ■FH05 シリーズ FH05series

#### FH05 シリーズ (光通信モジュール用) FH05Series (Optical communication related equipment)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値許容差 (%) R25 Resistance tolerance at 25°C			B定数許容差 B25/50 (%) B value tolerance			抵抗値 R25 resistance	B定数 B25/50 B value	B定数 B25/85 B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
		±1	±2	±3	±1							
6D103*C	-40~+125°C	±1	±2	±3	±1			10kΩ	3,930K	3,941K	15	0.15

### ■FH10 シリーズ FH10series

#### FH10 シリーズ (光通信モジュール用) FH10Series (Optical communication related equipment)

型名 (type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値許容差 (%) R25 Resistance tolerance at 25°C			B定数許容差 B25/50 (%) B value tolerance			抵抗値 R25 resistance	B定数 B25/50 B value	B定数 B25/85 B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation
		±1	±2	±3	±1							
6E103*C	-40~+125°C	±1	±2	±3	±1			10kΩ	3,950K	4,000K	30	0.3
6Q103*C		±1	±2	±3	±1			10kΩ	3,410K	3,455K		
3U104*C		±1	±2	±3	±1			100kΩ	3,950K	4,024K		

### ■推奨はんだ条件 Recommended Soldering Profile

FH シリーズ Au/Sn はんだ実装 FH Series Au/Sn Solder mounting  
 はんだ: Au/Sn (79/21) プリフォーム Solder: Au/Sn (79/21) Preform  
 実装装置: ダイボンダー Mounting device: Die bonder

N<sub>2</sub> 流量: 3L/min N<sub>2</sub> flow: 3L/min

実装温度: 320°C Mounting Temperature: 320°C

- 1) 280°Cを超える温度は 10 秒以内として下さい。 1) Please keep exposure to temperature exceeding 280°C to under 10seconds.
- 2) はんだ付け後は、急冷を避け、徐冷して下さい。 2) After soldering, do not force cool, allow the parts to cool gradually.